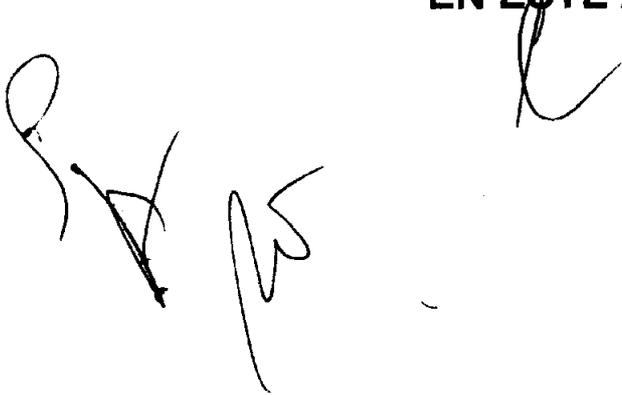


ANEXO 2

**SUSTITUCION DE LOS REQUISITOS ESPECIFICOS
DE ORIGEN CONTENIDOS EN EL ANEXO II DEL OCTAVO
PROTOCOLO ADICIONAL POR LOS QUE SE REGISTRAN
EN ESTE ANEXO**

Handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there are two distinct signatures. In the center, there are initials that appear to be 'MS'. On the right, there is a single, large, stylized signature.

ANEXO II

1. SECTOR LACTEO

N.C.M.	DESCRIPCIÓN	REQUISITO ESPECÍFICO
0402.10.10 0402.10.90 0402.21.10 0402.21.20 0402.29.10 0402.29.20	LECHE Y NATA (CREMA), O CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE.	Deberán ser elaborados a partir de leche producida en los Estados Partes.
0405.10.00	MANTECA (MANTEQUILLA)	

2. SECTOR QUIMICO

N.C.M.	DESCRIPCIÓN	REQUISITO ESPECÍFICO
Capítulos 28 y 29		Deberán cumplir con el requisito de origen establecido en la inciso "c", del artículo 3º, del Régimen General y deben obtenerse mediante un proceso productivo que traduzca una modificación molecular resultante de una sustancial transformación y que cree una nueva identidad química.

3. SECTOR SIDERURGICO.

N.C.M.	DESCRIPCIÓN	REQUISITO ESPECÍFICO
7208.10.00 7208.25.00 7208.26.10 7208.26.90 7208.27.10 7208.27.90	PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA SUPERIOR O IGUAL A 600 MM, LAMINADOS EN CALIENTE, SIN CHAPAR NI REVESTIR.	a - Deberán ser producidos a partir de productos incluidos en la partida 7206 o 7207, fundidos y moldeados o colados en los Estados Partes

N.C.M.	DESCRIPCIÓN	REQUISITO ESPECÍFICO
7208.36.10 7208.36.90 7208.37.00 7208.38.10 7208.38.90 7208.39.10 7208.39.90 7208.40.00 7208.51.00 7208.52.00 7208.53.00 7208.54.00 7208.90.00	PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA SUPERIOR O IGUAL A 600 MM , LAMINADOS EN FRÍO, SIN CHAPAR NI REVESTIR	a - Deberán ser producidos a partir de productos incluidos en la partida 7206 o 7207, fundidos y moldeados o colados en los Estados Partes
7209.16.00 7209.17.00 7209.18.00 7209.26.00 7209.27.00 7209.28.00 7209.90.00	PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA SUPERIOR O IGUAL A 600 MM , LAMINADOS EN FRÍO, CHAPADOS O REVESTIDOS	a - Deberán ser producidos a partir de productos incluidos en la partida 7206 o 7207, fundidos y moldeados o colados en los Estados Partes
7210.12.00 7210.30.10 7210.41.10 7210.49.10 7210.50.00 7210.61.00 7210.69.00 7210.90.00	PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA INFERIOR A 600 MM , SIN CHAPAR NI REVESTIR	a - Deberán ser producidos a partir de productos incluidos en la partida 7206 o 7207, fundidos y moldeados o colados en los Estados Partes
7211.14.00 7211.19.00 7211.23.00 7211.29.10 7211.29.20 7211.90.90		

N.C.M.	DESCRIPCIÓN	REQUISITO ESPECÍFICO
7212.10.00 7212.20.10 7212.30.00 7212.40.10 7212.40.20 7212.50.00	PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR ANCHURA INFERIOR A 600 MM , CHAPADOS O REVESTIDOS	a - Deberán ser producidos a partir de productos incluidos en la partida 7206 o 7207, fundidos y moldeados o colados en los Estados Partes
7213.10.00 7213.20.00 7213.91.90 7213.99.90	ALAMBRO DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR	a - Deberán ser producidos a partir de productos incluidos en la partida 7206 o 7207, fundidos y moldeados o colados en los Estados Partes
7214.10.10 7214.10.90 7214.20.00 7214.30.00 7214.91.00 7214.99.10 7214.99.90	BARRAS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, SIMPLEMENTE FORJADAS, LAMINADAS O EXTRUIDAS, EN CALIENTE, ASÍ COMO LAS SOMETIDAS A TORSIÓN DESPUÉS DEL LAMINADO	a - Deberán ser producidos a partir de productos incluidos en la partida 7206 o 7207, fundidos y moldeados o colados en los Estados Partes
7215.10.00 7215.50.00 7215.90.10 7215.90.90	LAS DEMÁS BARRAS DE HIERRO Ó ACERO SIN ALEAR	a - Deberán ser producidos a partir de productos incluidos en la partida 7206 o 7207, fundidos y moldeados o colados en los Estados Partes
7216.10.00 7216.21.00 7216.22.00 7216.31.00 7216.32.00 7216.33.00 7216.50.00	PERFILES DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR	a - Deberán ser producidos a partir de productos incluidos en la partida 7206 o 7207, fundidos y moldeados o colados en los Estados Partes
7217.10.10 7217.10.90 7217.20.10	ALAMBRE DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR	a - Deberán ser producidos a partir de productos incluidos en la partida 7206 o 7207, fundidos y moldeados o colados en los Estados Partes

N.C.M.	DESCRIPCIÓN	REQUISITO ESPECÍFICO
7217.20.90 7217.30.10 7217.30.90 7217.90.00	PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE ACERO INOXIDABLE, DE ANCHURA SUPERIOR O IGUAL A 600 MM	b - Deberán ser producidos a partir de productos incluidos en la partida 7218 fundidos y moldeados o colados en los Estados Partes
7219.33.00 7219.34.00 7219.35.00 7219.90.90	PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE ACERO INOXIDABLE, DE ANCHURA INFERIOR A 600 MM	b - Deberán ser producidos a partir de productos incluidos en la partida 7218 fundidos y moldeados o colados en los Estados Partes
7220.12.20	BARRAS Y PERFILES DE ACERO INOXIDABLE	b - Deberán ser producidos a partir de productos incluidos en la partida 7218 fundidos y moldeados o colados en los Estados Partes
7222.20.00 7222.30.00	ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE	b - Deberán ser producidos a partir de productos incluidos en la partida 7218 fundidos y moldeados o colados en los Estados Partes
7223.00.00	PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE LOS DEMAS ACEROS ALEADOS DE ANCHURA SUPERIOR O IGUAL A 600 MM.	c - Deberán ser producidos a partir de productos incluidos en la partida 7224 fundidos y moldeados o colados en los Estados Partes
7225.11.00 7225.19.00 7225.91.00 7225.92.00 7225.99.00	PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE LOS DEMAS ACEROS ALEADOS DE ANCHURA INFERIOR A 600 MM.	c - Deberán ser producidos a partir de productos incluidos en la partida 7224 fundidos y moldeados o colados en los Estados Partes
7226.11.00 7226.19.00	BARRAS Y PERFILES, DE LOS DEMAS ACEROS ALEADOS; BARRAS HUECAS PARA PERFORACION, DE ACEROS	c - Deberán ser producidos a partir de productos incluidos en la partida 7224 fundidos y moldeados o colados en los Estados Partes

N.C.M.	DESCRIPCIÓN	REQUISITO ESPECÍFICO
7228.10.10 7228.20.00 7228.30.00 7228.40.00 7228.50.00 7228.60.00	ALEADOS O SIN ALEAR.	Estados Partes
7304.10.90 7304.21.10 7304.21.90 7304.29.10 7304.29.20 7304.29.31 7304.29.39 7304.29.90 7304.31.10 7304.31.90 7304.39.10 7304.39.20 7304.39.90 7304.49.00 7304.51.10 7304.51.90 7304.59.10 7304.59.90 7304.90.11 7304.90.19 7304.90.90	TUBOS Y PERFILES HUECOS, SIN SOLDADURA (SIN COSTURA), DE HIERRO O DE ACERO.	d - Deberán ser producidos a partir de productos incluidos en la posición 7206 ó 7207 ó 7218 ó 7224, fundidos y moldeados o colados en los Estados Partes.
7305.11.00 7305.12.00	LOS DEMÁS TUBOS (POR EJ: SOLDADOS O REMACHADOS) DE SECCION CIRCULAR CON DIÁMETRO EXTERIOR SUPERIOR A 406,4 mm, DE HIERRO Ó ACERO	d - Deberán ser producidos a partir de productos incluidos en la posición 7206 ó 7207 ó 7218 ó 7224, fundidos y moldeados o colados en los Estados Partes.
7305.19.00 7305.20.00 7305.31.00 7305.39.00 7305.90.00	Excepto tubos exclusivamente para caños elaborados con soldadura continua por resistencia eléctrica, de diámetro superior a 590 mm. e inferior a 630 mm. que estarán sujetos al Régimen General de Origen MERCOSUR (R.G.)	

Handwritten signatures and initials, including a large stylized 'S' and several other scribbles.

N.C.M.	DESCRIPCIÓN	REQUISITO ESPECÍFICO
7306.10.00	LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES d - Deberán ser producidos a HUECOS (POR EJ: SOLDADOS, partir de productos incluidos en REMACHADOS, GRAPADOS O CON la posición 7206 ó 7207 ó 7218 ó LOS BORDES SIMPLEMENTE 7224, fundidos y moldeados o APROXIMADOS), DE HIERRO O colados en los Estados Partes. ACERO.	
7306.20.00		
7306.30.00	Excepto tubos de acero aluminizado que estarán sujetos al Régimen General de Origen MERCOSUR (R.G.)	
7306.50.00		
7306.60.00		
7306.90.10		
7306.90.90		

4. SECTOR DE TELECOMUNICACIONES

Se aplica a las siguientes partidas de la NCM:

8517 (EXCEPTO: 8517.21, 8517.50.22, 8517.50.41, 8517.80.10, 8517.90.10); 8525 (EXCEPTO: 8525.20.11, 8525.20.12, 8525.20.21, 8525.20.23 y 8525.20.30); 8527.90.19, 8529.90.19, 8543.40.00, 8543.81.00, 8543.89.12, 8543.89.14, 8543.89.15, 8543.89.19, 8543.89.39, 8543.89.90,.

REQUISITO: Cumplir con el requisito de origen previsto en el art. 3° inciso "c" de la Decisión n° 06/94 y con el siguiente proceso productivo:

- A. Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto;
- B. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;
- C. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y
- D. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

5. SECTOR DE INFORMÁTICA

5.1 BÁSICO

Se aplica a los siguientes ítem de la NCM:

8470.50.11, 8470.50.19, 8471.30.90, 8471.41.90, 8471.49.15, 8471.49.21, 8471.49.22, 8471.49.23, 8471.49.31, 8471.49.35, 8471.49.37, 8471.49.41, 8471.49.43, 8471.49.45, 8471.49.46, 8471.49.48, 8471.49.51, 8471.49.52, 8471.49.53, 8471.49.54, 8471.49.55, 8471.49.56, 8471.49.57, 8471.49.59,

8471.49.65, 8471.49.68, 8471.49.69, 8471.49.71, 8471.49.73, 8471.49.75
 8471.49.76, 8471.49.91, 8471.49.92, 8471.49.93, 8471.49.94, 8471.49.95,
 8471.50.90, 8471.60.11, 8471.60.12, 8471.60.19, 8471.60.21, 8471.60.25,
 8471.60.29, 8471.60.41, 8471.60.49, 8471.60.52, 8471.60.53, 8471.60.59.
 8471.60.61, 8471.60.62, 8471.60.71, 8471.60.72, 8471.60.73, 8471.60.74,
 8471.60.80, 8471.60.99, 8471.70.31, 8471.70.39, 8471.70.90, 8471.80.11,
 8471.80.13, 8471.80.19, 8471.80.90, 8471.90.11, 8471.90.12, 8471.90.13,
 8471.90.19, 8471.90.90, 8472.90.10, 8472.90.21, 8472.90.29, 8472.90.59,
 8473.29.90, 8473.30.11, 8473.30.19, 8473.30.21, 8473.30.24, 8473.30.29,
 8473.30.31, 8473.30.39, 8473.30.99, 8473.40.90, 8473.50.32, 8473.50.39,
 8473.50.90, 8511.80.30, 8517.21.10, 8517.21.20, 8517.21.30, 8517.21.90,
 8531.20.00, 8537.10.11, 8537.10.19, 8537.10.20, 8540.50.20, 9026.10.11,
 9028.30.11, 9028.30.21, 9028.30.31, 9030.39.11, 9030.39.19, 9030.40.10,
 9030.40.20, 9030.40.30, 9030.40.90, 9030.82.10, 9030.82.90, 9030.83.10,
 9030.89.30, 9030.89.40, 9030.89.90, 9030.90.20, 9030.90.30, 9030.90.90,
 9031.80.40, 9032.89.11, 9032.89.21, 9032.89.22, 9032.89.23, 9032.89.24,
 9032.89.25, 9032.89.29, 9032.89.81, 9032.89.82, 9032.89.83, 9032.89.89.

REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:

- A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;
- B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y
- C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.

Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos:

- 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2;
- 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y
- 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11.

Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B".

No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.

5.2 MICROCOMPUTADORAS PORTÁTILES

Se aplica a los siguientes ítem de la NCM: 8471.30.12 y 8471.30.19.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller initials on the left.

REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:

- A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso que implementen las funciones de procesamiento y memoria, las controladoras de periféricos para teclado, y unidades de discos magnéticos y las interfases de comunicación en serie y paralela acumulativamente. Cuando las unidades centrales de procesamiento incorporen en el mismo cuerpo o gabinete, placas de circuito impreso que implementen las funciones de red local o emulación de terminal, estas placas también deberán tener el montaje y soldadura de todos sus componentes;
- B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y
- C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.

Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos:

- 1) Pantalla ("display") de los ítem 8473.30.91 y 8473.30.92; y
- 2) Teclado del ítem 8471.60.52.

No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.

5.3 UNIDADES DIGITALES DE PROCESAMIENTO DE PEQUEÑA CAPACIDAD

Se aplica a los siguientes ítem de la NCM: 8471.49.11 y 8471.50.10.

REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:

- A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso que implementan las funciones de procesamiento y memoria y las siguientes interfases: en serie, paralela, de unidades de discos magnéticos, de teclado y de video, acumulativamente.

Cuando las unidades centrales de procesamiento incorporen en el mismo cuerpo o gabinete placas de circuito impreso que implementen las funciones de red local o emulación de terminal, estas placas también deberán tener un montaje y soldadura de todos los componentes. En las unidades digitales de procesamiento del tipo "discless", destinadas a interconexión en redes locales, el montaje de la placa que implementa la interfase de red local podrá sustituir el montaje de las placas que implementan las interfases en serie, paralela y de unidades de discos magnéticos;

- B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y
- C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" e "B" anteriores.

No desnaturaliza el cumplimiento del Régimen de Origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.

5.4 UNIDADES DIGITALES DE CAPACIDAD MEDIANA Y GRANDE

Se aplica a los siguientes ítem de la NCM: 8471.49.12, 8471.49.13, 8471.50.20 y 8471.50.30.

REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:

- A. Montaje y soldadura de todos los componentes en el conjunto de placas de circuito impreso que implementen como mínimo 3 (tres) de las 5 (cinco) siguientes funciones: a) procesamiento central; b) memoria; c) unidad de control integrada/interfase o controladoras de periféricos; d) soporte y diagnóstico de sistema; e) canal o interfase de comunicación con unidad de entrada y salida de datos y periféricos; o, alternativamente, el montaje de por lo menos 4 (cuatro) placas de circuito impreso que implementen cualquiera de estas funciones;
- B. Montaje e integración de las placas de circuito impreso y de los conjuntos eléctricos y mecánicos en la formación del producto final; y
- C. Cuando el montaje del producto se realice con conjuntos en forma de cajón, estos conjuntos deberán ser montados a partir de sus subconjuntos, tales como: fuente de alimentación, placas de circuito impreso y cables.

Cuando la empresa opte por el montaje del número de placas de circuito impreso, establecido en el ítem "A", en caso de que se utilice placas que sean padrones del mercado, como por ejemplo, placas de memoria del tipo "SIMM" del ítem 8473.30.42 o 8473.50.50, se considerará una placa por función, independientemente de la cantidad de placas montadas para implementar la función.

Para cumplir con lo dispuesto se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A", "B" y "C".

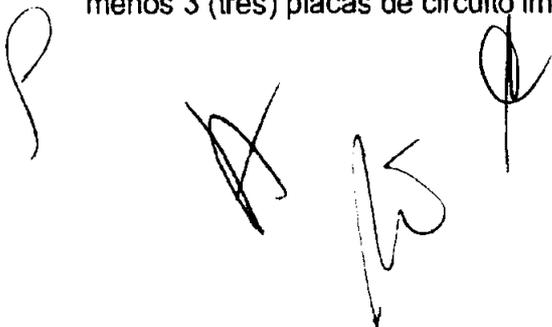
Lo dispuesto en este Régimen, también se aplica a las unidades de control de periféricos, tales como controladores de discos, cintas, impresoras y lectoras ópticas y/o magnéticas y las expansiones de las funciones mencionadas en el ítem "A", incluso cuando no se presenten en el mismo cuerpo o gabinete de las unidades digitales de procesamiento.

5.5 UNIDADES DIGITALES DE CAPACIDAD MUY GRANDE

Se aplica a los siguientes ítem de la NCM: 8471.49.14 y 8471.50.40.

REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:

- A. Montaje y soldadura de todos los componentes en el conjunto de placas de circuito impreso que implementen por lo menos 2 (dos) de las 5 (cinco) siguientes funciones: a) procesamiento central; b) memoria c) unidad de control integrada/interfase; d) soporte y diagnóstico de sistemas; e) canal de comunicación, o alternativamente, el montaje de por lo menos 3 (tres) placas de circuito impreso que implementen cualquiera de estas funciones:



- B. Montaje e integración de las placas de circuito impreso y de los conjuntos eléctricos y mecánicos en la formación del producto final; y
- C. Cuando el montaje del producto se realice con conjuntos en forma de cajón, estos conjuntos deberán ser montados a partir de sus subconjuntos, tales como: fuentes de alimentación, placas de circuito impreso y cables.

Cuando la empresa opte por el montaje del número de placas de circuito impreso establecido en el ítem "A", en caso de que se utilice placas que sean padrones de mercado, como por ejemplo, placas de memoria del tipo "SIMM", de los ítem 8473.30.42 o 8473.50.50, se considerará una placa por función, independientemente de la cantidad de placas montadas para implementar la función.

Para cumplir con lo dispuesto se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A", "B" y "C".

Lo dispuesto en este Régimen también se aplica a las unidades de control de periférico, tales como controladoras de discos, cintas, impresoras y lectoras ópticas y/o magnéticas y a las expansiones de las funciones mencionadas en el ítem "A", incluso cuando no se presenten en el mismo cuerpo o gabinete de las unidades digitales de procesamiento.

5.6 DISCOS DUROS

Se aplica a los siguientes ítem de la NCM: 8471.49.62, 8471.49.63, 8471.70.12 y 8471.70.19.

REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:

- A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;
- B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas a nivel básico de componentes;
- C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" ;
- D. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B", y
- E. Para la producción de discos magnéticos duros con capacidad de almacenaje superior a 1 (un) GBYTES por HDA (Head Disk Assembly) no formateado, podrá optarse entre cumplir con lo dispuesto en los ítem "A" o "B" y en caso de cumplirse con lo dispuesto en el ítem "A" deberán ser soldados y montados todos los componentes en las placas de circuito impreso que implementen por lo menos dos de las siguientes funciones: a) comunicación con la unidad controladora de disco; b) posicionamiento de los conjuntos de lectura y grabación; c) o lectura y grabación.

5.7 CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS

Se aplica a los siguientes ítem de la NCM: 8473.29.10, 8473.30.41, 8473.30.49, 8473.40.10, 8473.50.10, 8517.90.10, 8529.90.12 y 9032.90.10.

REQUISITO: Montaje y soldadura en las placas de circuito impreso de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8473.30.

5.8 PLACAS (MÓDULOS DE MEMORIA) CON UNA SUPERFICIE INFERIOR O IGUAL A 50CM2

Se aplica a los siguientes ítem de la NCM: 8473.30.42 y 8473.50.50.

REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:

- A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada;
- B. Encapsulamiento de la pastilla;
- C. Test (ensayo) eléctrico;
- D. Marcación (identificación) del componente (memoria); y
- E. Montaje y soldadura de los componentes semiconductores (memoria) en el circuito impreso.

5.9 COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS

Se aplica a los siguientes ítem de la NCM:

8541.10.22;	8541.10.29;	8541.10.92;	8541.10.99;	8541.29.20
8541.30.21	8541.30.29;	8541.40.16	8541.40.21	8541.40.22;
8541.40.26;	8541.50.20;	8542.12.00;	8542.13.21;	8542.13.29
8542.13.91	8542.13.99	8542.14.20;	8542.14.90	8542.19.21
8542.19.29	8542.19.91	8542.19.99	8542.30.21	8542.30.29

REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:

- A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada;
- B. Encapsulamiento de la pastilla montada;
- C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico;
- D. Marcación (identificación);
- E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductor; y
- F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores.

5.10 COMPONENTES A PELÍCULA ESPESA O A PELÍCULA FINA

Se aplica a los siguientes ítem de la NCM: 8542.40.10 y 8542.40.90.

REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:

- A. Procesamiento físico-químico sobre sustrato;
- B. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico;
- C. Marcación (identificación); y
- D. Para la producción de circuitos integrados híbridos están exentos de atender los ítem "A", "B" y "C" los componentes semiconductores utilizados como insumos en la producción de los mismos.

5.11 CÉLULAS FOTOVOLTAICAS

Se aplica a los siguientes ítem de la NCM: 8541.40.31 y 8541.40.32.

REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:

- A. Procesamiento físico-químico referente a etapas de división, texturización y metalización;
- B. Encapsulamiento de la pastilla montada;
- C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; y
- D. Marcación (identificación).

5.12 CABLES ÓPTICOS

Se aplica a los siguientes ítem de la NCM: 8544.70.10; 8544.70.30; 8544.70.90 y 9001.10.20.

REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:

- A. Pintura de fibras;
- B. Reunión de fibras en grupos;
- C. Reunión para formación de núcleos;
- D. Extrusión de la capa o aplicación de armazón metálica y marcación;
- E. Se admitirá la realización de las actividades descritas en los ítem "A" y "B" por terceros, siempre que se efectúe en uno de los Estados Partes;
- F. Las empresas deberán realizar actividades de ingeniería referentes al desarrollo y adaptación del producto a su fabricación y test (ensayos) de aceptación operativa; y
- G. Los cables ópticos deberán utilizar fibras ópticas que atiendan el requisito específico de origen definido para las mismas.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large stylized 'S' on the left, a large 'A' in the center, and a large 'B' on the right, with a vertical scribble to the right of the 'B'.

5.13 FIBRAS ÓPTICAS

Se aplica a los siguientes ítem: 9001.10.11 y 9001.10.19.

REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:

- A. Procesamiento físico-químico que resulte en la obtención de la preforma;
- B. Estiramiento de la fibra;
- C. Test;
- D. Embalaje;
- E. Se admitirá la realización de la actividad descrita en el ítem "A" por terceros, siempre que se efectúe en uno de los Estados Partes; y
- F. Las empresas deberán realizar actividades de ingeniería referentes al desarrollo y adaptación del producto a su fabricación y test (ensayos).

The image shows four handwritten marks in black ink. From left to right: a stylized signature, a set of initials, another stylized signature, and a signature with a horizontal line drawn through it.